

日清紡メカトロニクスとエレファンテック、IMPC™技術を用いた ADAS 搭載車向け成形部品の開発について基本合意

このたび、日清紡メカトロニクス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：増田 敏浩、以下「日清紡メカトロニクス」）とエレファンテック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清水信哉、以下「エレファンテック」）は、日清紡メカトロニクスグループの保有する射出成形技術と、エレファンテックの保有する立体配線技術である IMPC™技術※とを組み合わせ、ADAS 搭載車向け配線一体型成形部品の開発を行う旨の基本合意を締結しました。

日清紡メカトロニクスグループは、保有する射出成形技術、エレクトロニクス技術、自動車部品製造ノウハウをベースに、エレファンテックの IMPC™技術を取り入れ、樹脂と配線・機能が一体化した車載用各種成形部品の開発を加速します。すでに ADAS 搭載車向け配線一体型成形部品のプロトタイプは完成しており、今後は量産に向けた開発を進め、2023 年の量産開始を目指します。

安全・安心なモビリティ社会の実現のため、車載センシングの重要性は増々高まっております。今後、さらに高度化する自動運転を実現させるためには、多くの部品と製造工程が必要です。今後、いかに少ない部品と短い製造工程で、多様なセンサー等を自動車にインテグレーションできるかが大きな課題となっています。

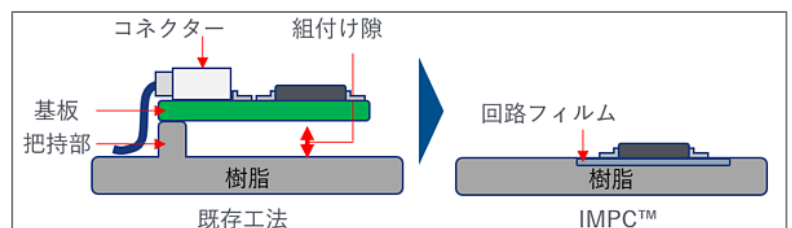
エレファンテックの提供する IMPC™技術はその課題に対するソリューションの一つと期待されており、他社にないインクジェット印刷と無電解銅めっきによる配線印刷技術を強みとしています。さらに、差別化された配線印刷技術と日清紡メカトロニクスのグループ会社が保有するフィルムインサート成形技術を組み合わせ、立体的な配線を製造する技術である IMPC™を展開していきます。両社のコア技術を融合して、樹脂成形部品と配線を一体化することにより、少ない部品点数で多くの機能を搭載することが可能になります。今後はさらに、両社が持つ技術の応用展開と協業により新たな製品の企画・開発を目指します。

以上

※ IMPC™ (In-Mold Printed Circuit) 技術

これまで樹脂と電子回路それぞれ別々に設計・製造し、組み合わせて作られていた部分最適化の構造に対して、部品全体での一体化・最適化を提供する設計・製造するソリューションです。

樹脂と回路を一体化してより広い範囲での最適化設計が行えるため、軽量化、薄型化、コスト減等の様々なメリットを実現できます。



■会社概要

会社名	日清紡メカトロニクス株式会社
本社所在地	東京都中央区日本橋人形町二丁目 31 番 11 号
資本金	4,000 百万円 (2019 年 12 月 31 日時点)
事業内容	成形品の開発、製造、販売 各種専用機の開発、製造、販売 自動車用精密部品の製造、販売、他
URL	http://www.nisshinbo-mechatronics.co.jp/

<報道関係者お問い合わせ先>

日清紡ホールディングス株式会社 IR 広報グループ TEL 03-5695-8854

<事業・製品に関するお問い合わせ先>

日清紡メカトロニクス株式会社 事業統括部 TEL 0564-55-1111

会社名	エレファンテック株式会社
本社所在地	東京都中央区八丁堀四丁目 3 番 8 号
資本金	310 百万円
事業内容	プリントド・エレクトロニクス製造技術の開発、サービス提供 アディティブ・マニファクチュアリングを用いた製造技術の開発
URL	https://www.elephantech.co.jp/

< IMPC™技術等に関するお問い合わせ先>

エレファンテック株式会社 広報担当 pr@elephantech.co.jp